



20 Jahre AML-Technik

Embedding von aktiven und passiven Bauteilen in Leiterplatten

bayern  innovativ

der beitrage der leiterplatte zur digitalisierung.

APPLIKATIONEN AUS AUTOMOBIL-, INDUSTRIE- UND MEDIZINELEKTRONIK

13. Kooperationsforum mit Fachausstellung

PCB 4.0 - Baugruppen mit eingebetteten Mikrosensorensystemen zur intelligenten Fertigung von Industrieelektronik

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium für Bildung und Forschung

Industrie 4.0

